

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2006 Thomson Derwent. All rts. reserv.

009813393 **Image available**

WPI Acc No: 1994-093249/199412

XRPX Acc No: N94-073106

High speed drilling of PCB(s) - directing perpendicular cooling jet onto drill bit during drilling and cooling pauses between drilling cycles

Patent Assignee: WUERTH ELEKTRONIK GMBH & CO KG (WUER-N)

Inventor: BINDER H

Number of Countries: 010 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
DE 4230625	A1	19940317	DE 4230625	A	19920912	199412 B
EP 588244	A2	19940323	EP 93114525	A	19930910	199412
EP 588244	A3	19940608	EP 93114525	A	19930910	199526

Priority Applications (No Type Date): DE 4230625 A 19920912

Cited Patents: 1.Jnl.Ref; DE 3939374; FR 2323496; US 2067676; US 4915550

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

DE 4230625	A1		4	H05K-003/00	
------------	----	--	---	-------------	--

EP 588244	A2 G		4		
-----------	------	--	---	--	--

Designated States (Regional): AT CH DE DK FR GB IT LI NL SE

EP 588244	A3			H05K-003/00	
-----------	----	--	--	-------------	--

Abstract (Basic): DE 4230625 A

A jet of a gas or liquid cooling medium is directed onto the drill bit (4) shortly in front of its point of contact with the circuit board to achieve effective cooling and allow shorter pauses between successive drilling cycles.

Pref. the cooling jet is directed onto the drill bit perpendicular to its axis and is maintained during drilling and during the pauses between successive drilling cycles. Liquid nitrogen or carbon dioxide can be used as the cooling medium.

ADVANTAGE - Allows large number of precision bores to be drilled in surface of circuit board in relatively short time.

Dwg.1/1

Title Terms: HIGH; SPEED; DRILL; PCB; DIRECT; PERPENDICULAR; COOLING; JET; DRILL; BIT; DRILL; COOLING; PAUSE; DRILL; CYCLE

Derwent Class: P56; V04

International Patent Class (Main): H05K-003/00

International Patent Class (Additional): B23Q-011/10

File Segment: EPI; EngPI

BEST AVAILABLE COPY

19



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



11 Veröffentlichungsnummer: **0 588 244 A2**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: **93114525.4**

51 Int. Cl.⁵: **H05K 3/00, B23Q 11/10**

22 Anmeldetag: **10.09.93**

30 Priorität: **12.09.92 DE 4230625**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
23.03.94 Patentblatt 94/12

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE DK FR GB IT LI NL SE

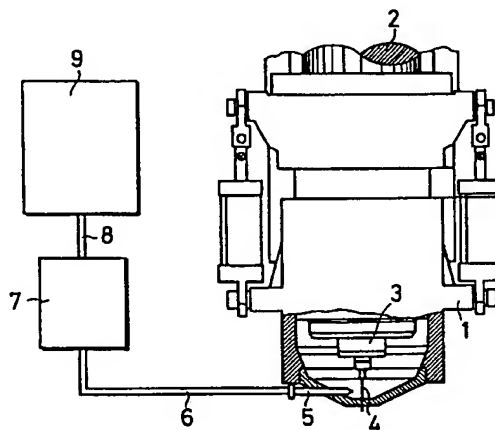
71 Anmelder: **WÜRTH ELEKTRONIK GmbH & Co.
KG
Salzstrasse 21
D-74676 Niedernhall(DE)**

72 Erfinder: **Blinder, Herbert
Fessbacher Strasse 12
D-74635 Kupferzell(DE)**

74 Vertreter: **Patentanwälte Ruff, Beler,
Schöndorf und Mütschele
Willy-Brandt-Strasse 28
D-70173 Stuttgart (DE)**

54 Verfahren und Vorrichtung zum Bohren von Leiterplatten.

57 Beim Bohren von Leiterplatten mit Hilfe von hochtourig arbeitenden Mikrobohrern tritt eine starke Erhitzung der Bohrer auf. Zur Verbesserung der Schnittleistung und zur Verbesserung der Qualität der gebohrten Löcher wird vorgeschlagen, den Bohrer während des Bohrens durch einen direkt auf ihn gerichteten Strahl kalten Kühlmittels in Form eines Gases und/oder einer Flüssigkeit zu kühlen.



EP 0 588 244 A2

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Bohren von Leiterplatten.

Leiterplatten, die bei vielen Anwendungsfällen aus 1, 2 oder mehreren Lagen bestehen, müssen gebohrt werden, damit eine leitende Verbindung zwischen den einzelnen Lagen hergestellt werden kann. Die Bohrungen werden nach Herstellung durchkontaktiert. Die Leiterplatten enthalten häufig sehr große Zahlen von Bohrungen, die zudem noch auf sehr engem Raum untergebracht sind und sehr kleine Durchmesser aufweisen.

Zum Bohren werden sehr feine Bohrer verwendet, die mit einer sehr hohen Drehzahl arbeiten, beispielsweise im Bereich von mehreren zigtausend Umdrehungen pro Minute. Dabei erhitzen sich die Bohrer auf Temperaturen, bei denen die Schneideigenschaften der Bohrer und die Qualität der Löcher abnimmt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, auch bei hohen Anforderungen dafür zu sorgen, daß die Bohrlöcher eine hohe Qualität aufweisen.

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfindung ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 9 vor. Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

Erfindungsgemäß wird also der Bohrer in einem bestimmten Bereich gekühlt, nämlich außerhalb der Leiterplatte. Es erfolgt damit keine Beeinträchtigung der Leiterplatte, sondern nur eine Kühlung des Bohrers selbst. Insbesondere kann vorgesehen sein, daß der Kühlmittelstrahl direkt auf den Bohrer gerichtet wird. Als Kühlmittel wird mit Vorteil ein gekühltes Gas verwendet. Ist das Kühlmittel eine Flüssigkeit, dann ist diese mit Vorteil eine solche, die bei Umgebungstemperatur oder bei tieferen Temperaturen rückstandsfrei verdampft. Der Kühlmittelstrahl kann auch aus einem Gemisch aus Flüssigkeit und Gas bestehen.

In Weiterbildung kann vorgesehen sein, daß der Kühlstrahl senkrecht zur Bohrerachse verläuft.

Die Erwärmung des Bohrers erfolgt während des Bohrens selbst. Nach dem Bohren eines Lochs wird der Bohrer zurückgezogen, seitlich versetzt und anschließend zum Bohren eines weiteren Lochs wieder abgesenkt. Die Erfindung schlägt in Weiterbildung nun vor, den Kühlmittelstrahl sowohl während des Bohrens als auch während des Rückzuges des Bohrers und vorzugsweise auch während der Pausen zwischen den Bohrvorgängen aufrechtzuerhalten. Der Bohrer kann also auch während der Zeit, in der er sich nicht erwärmt, weiter gekühlt werden.

Es kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, daß zur Verbesserung der Kühlung die Pausen zwischen den Bohrvorgängen vergrößert werden können.

Erfindungsgemäß wird der Gasstrahl mit Vorteil in den Niederhalter des Bohrkopfs eingeblasen.

Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, als Quelle für den Gasstrahl flüssiges Kohlendioxid oder auch flüssigen Stickstoff zu verwenden.

Die von der Erfindung vorgeschlagene Vorrichtung enthält eine Einspritzdüse, die mit einer Kühlmittelquelle verbunden ist und deren Verlängerung den Bohrer bzw. dessen Achse insbesondere rechtwinklig trifft. Der aus der Einspritzdüse austretende Kühlmittelstrahl trifft damit exakt den Bohrer selbst.

Erfindungsgemäß kann zwischen der Kühlmittelquelle, beispielsweise einem Behälter für flüssigen Stickstoff oder flüssiges Kohlendioxid, und der Einspritzdüse eine Dosiereinrichtung vorgesehen sein, die insbesondere dazu dienen kann, die Geschwindigkeit des Ausströmens des Kühlmittels konstant zu halten oder zu regeln. Die Dosiereinrichtung kann ebenfalls eine Kontrolleinrichtung aufweisen, in der beispielsweise bei Stillsetzen des Bohrers auch die Kühlung stillgelegt wird.

Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorzüge der Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sowie anhand der Zeichnung.

Hierbei zeigt die einzige Zeichnungsfigur schematisch eine Anordnung eines Niederhalters mit einer Kühlung nach der Erfindung.

Der in der Figur dargestellte Niederhalter 1 ist an sich bekannt und wird daher nicht im einzelnen erläutert. In seinem oberen Bereich weist er eine Spindel 2 auf, die zum Drehantrieb dient. In seinem unteren Bereich ist eine Spannvorrichtung 3 für den Bohrer 4 zu sehen. Der Bohrer ragt an der Unterseite aus dem Niederhalter 1 heraus. Bei dem Bohrer kann es sich um einen Mikrobohrer in dem bei der Bohrung von Platinen üblichen Bereich von etwa 0,1 - 6,5 mm Durchmesser oder um Fräser handeln.

Der Niederhalter 1 weist in diesem Bereich eine Einspritzdüse 5 auf, die etwa radial angeordnet ist. Die Einspritzdüse zielt auf die Bohrerachse 4 und trifft diese unter einem rechten Winkel. Die Einspritzdüse 5 ist über eine schematisch dargestellte Leitung 6 mit einem Dosier- und Kontrollgerät 7 verbunden, das seinerseits über eine weitere Leitung 8 mit einem Behälter 9 verbunden ist. In dem Behälter 9 ist beispielsweise flüssiges Kohlendioxid enthalten, das, kontrolliert durch das Gerät 7, über die Leitung 6 zu der Einspritzdüse 5 fließt. Beim Austreten aus der Einspritzdüse 5 verdampft das flüssige Gas mindestens teilweise und erzeugt einen kalten Kühlmittelstrom, der direkt auf den Bohrer gerichtet ist. Insbesondere bei Verwendung von flüssigem Stickstoff als Kühlmittel kann der Flüssigkeitsstrahl direkt an den Bohrer gelangen. Der Bohrer wird sowohl während des Bohrens

selbst, also während des Vorschubs des Bohrers, gekühlt, als auch während der zwischen den einzelnen Bohrvorgängen auftretenden Pausen. Eine Erwärmung des Bohrers tritt nur während des Bohrvorgangs auf, so daß er während der folgenden Pause auch dann abgekühlt werden kann, wenn die Kühlleistung nicht ausreicht, seine Erwärmung während des Bohrvorgangs zu verhindern.

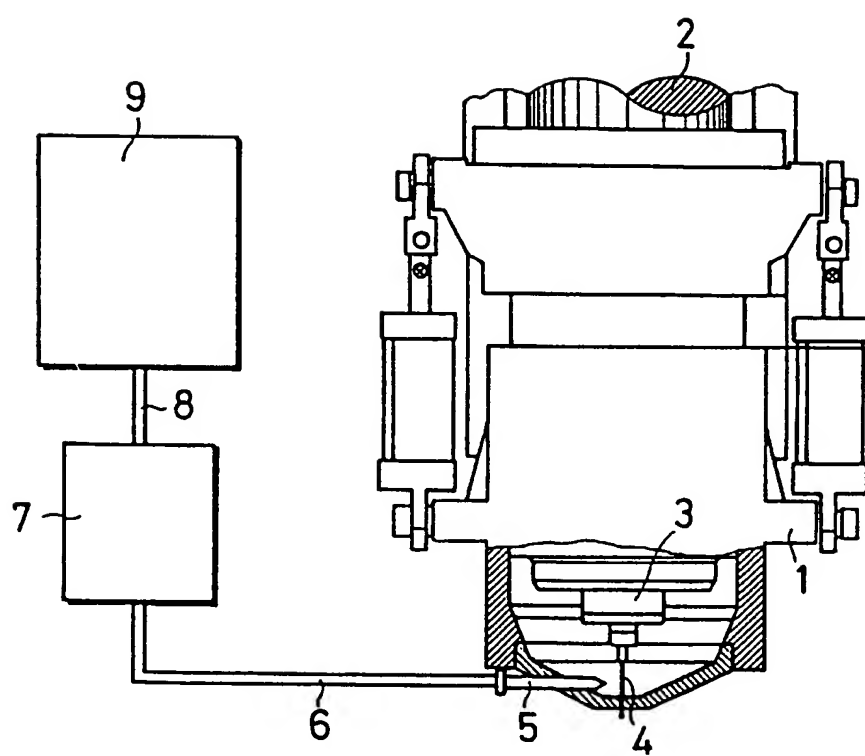
Wenn eine Maschine mehrere Niederhalter, bzw. Spindeln aufweist, so kann erfindungsgemäß vorgesehen sein, daß für jeden Niederhalter, bzw. Spindel eine derartige Einspritzdüse 5 vorgesehen ist.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Bohren von Leiterplatten, bei dem der Bohrer (4) in seinem Bereich kurz vor der Leiterplatte mit Hilfe mindestens eines Strahles eines Kühlmittels aus einem Gas- und/oder einer Flüssigkeit gekühlt wird. 20
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Kühlmittelstrahl direkt auf den Bohrer (4) gerichtet wird. 25
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Kühlmittelstrahl senkrecht zur Bohrerachse verläuft. 30
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Kühlmittelstrahl sowohl während des Bohrens als auch während der Pausen zwischen den Bohrvorgängen aufrechterhalten wird. 35
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem zur Verbesserung der Kühlung die Pausen zwischen den Bohrvorgängen vergrößert werden. 40
6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Kühlmittelstrahl in den Niederhalter etwa radial eingebracht wird. 45
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem als Kühlmittelquelle flüssiges Kohlendioxid verwendet wird.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem als Kühlmittelquelle flüssiger Stickstoff verwendet wird. 50
9. Vorrichtung zum Bohren von Leiterplatten, mit einem Bohrer (4) und einem Niederhalter (1), an dem eine Einspritzdüse (5) angeordnet ist, die mit einer Kühlmittelquelle (9) verbunden ist und deren Verlängerung den Bohrer (4) bzw.

dessen Achse trifft.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, bei der die Verlängerung der Einspritzdüse (5) die Bohrerachse rechtwinklig trifft. 5
11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, bei der die Kühlmittelquelle (9) ein Behälter mit flüssigem Kohlendioxid ist. 10
12. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, bei der die Kühlmittelquelle (9) ein Behälter mit flüssigem Stickstoff ist.
13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 12, bei der zwischen der Kühlmittelquelle (9) und der Einspritzdüse (5) eine Dosier- und Kontrolleinrichtung (7) vorgesehen ist. 15



(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 588 244 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 93114525.4

(51) Int. Cl.⁵: H05K 3/00, B23Q 11/10

(22) Anmeldetag: 10.09.93

(30) Priorität: 12.09.92 DE 4230625

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
23.03.94 Patentblatt 94/12

(64) Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE DK FR GB IT LI NL SE

(58) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 08.06.94 Patentblatt 94/23

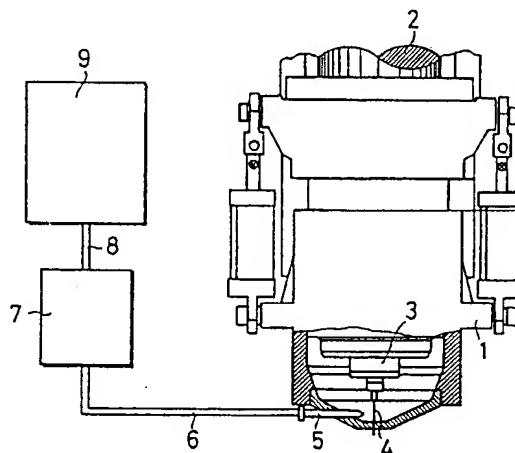
(71) Anmelder: WÜRTH ELEKTRONIK GmbH & Co.
KG
Salzstrasse 21
D-74676 Niedernhall(DE)

(72) Erfinder: Binder, Herbert
Fessbacher Strasse 12
D-74635 Kupferzell(DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte Ruff, Beler,
Schöndorf und Mütschele
Willy-Brandt-Strasse 28
D-70173 Stuttgart (DE)

(54) Verfahren und Vorrichtung zum Bohren von Leiterplatten.

(57) Beim Bohren von Leiterplatten mit Hilfe von hochtourig arbeitenden Mikrobohrern tritt eine starke Erhitzung der Bohrer auf. Zur Verbesserung der Schnittleistung und zur Verbesserung der Qualität der gebohrten Löcher wird vorgeschlagen, den Bohrer (4) während des Bohrens durch einen direkt auf ihn (4) gerichteten Strahl kalten Kühlmittels in Form eines Gases und/oder einer Flüssigkeit zu kühlen.



EP 0 588 244 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 93 11 4525

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.5)
X	FR-A-2 323 496 (INFRANOR SA) * Seite 1, Zeile 20 * * Seite 2, Zeile 17 - Zeile 21 * * Seite 5, Zeile 2 - Zeile 4 * * Abbildungen * ---	1,2,6,9	H05K3/00 B23Q11/10
X	IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN. Bd. 23, Nr. 8, Januar 1981, NEW YORK US Seite 3800 R. H. FRANKLIN 'Drilling of multilayer substrates with laminated metal foil interfaces' * das ganze Dokument * ---	1,2	
A	US-A-4 915 550 (ARAI ET AL.) * Spalte 4, Zeile 10 - Spalte 5, Zeile 17; Abbildungen * ---	1,6,9,10	
A	US-A-2 067 676 (LEES) * Seite 2, linke Spalte, Zeile 57 - Zeile 74; Abbildung 3 * ---	1,2,7,11	
A	DE-A-39 39 374 (REBO-PLASTIC GMBH & CO.) * Ansprüche * -----	1,8	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.5)
			H05K B23Q
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenart DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29. März 1994	Prüfer Mes, L
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.